

公益社団法人 砥粒加工学会
次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会 第39回研究会開催案内

【研究会テーマ】 「大型平面ガラス基板の高精度加工技術の最新動向
～研磨砥粒に焦点を当てて～」

【日時】 平成23年10月21日（金）13：00～17：15（技術交流会17：30～19：30）

【会場】 上智大学・中央図書館・L-821室（8階）

【住所】 〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町 7番1号

【アクセス】 JR中央線・東京メトロ丸ノ内線・同南北線／四ッ谷駅下車
麴町口・赤坂口から徒歩5分

【ホームページ】 http://www.sophia.ac.jp/jpn/info/access/accessguide/access_yotsuya
http://www.sophia.ac.jp/jpn/info/access/map/map_yotsuya

【研究会プログラム】

- 13：00～13：05 「開会の挨拶」
元東海大学 安永 暢男 委員長
- 13：05～14：05 「液晶向け大型平面ガラス基板の研磨加工技術の動向と
注目される最新砥粒技術について」
九州大学工学研究院 土肥 俊郎 氏
- 14：05～15：00 「酸化セリウムメーカーから見たガラス加工の現状」
テクノライズ株式会社 谷口 佳伸 氏
- 15：00～15：15 休憩
- 15：15～16：10 「地球資源的見地からの化学研磨」
株式会社電硝エンジニアリング 高倉 康一 氏
- 16：10～17：10 「電界砥粒制御技術が拓くガラス表面仕上げに於ける
酸化セリウムの有効活用法」
秋田県産業技術センター 赤上 陽一 氏
- 17：10～17：15 「閉会の挨拶と連絡」
元東海大学 安永 暢男 委員長

【技術交流会】

17：30～19：30 上智大学・11号館7階・第一会議室（立食形式・参加費無料）

【参加費】

専門委員会会員：無料
非会員：15,000 円（1社2名まで）

【申込締切】

2011年10月17日（月）17：00まで

【申し込み・問い合わせ】

幹事：埼玉大学大学院理工学研究科 澁谷 秀雄

TEL&FAX：048-858-9202 E-mail：shibutani@mech.saitama-u.ac.jp

下記の申込票に必要事項をご記入の上、ご返信・ご返送下さい。

..... 参加申込票

ご芳名：

勤務先：

連絡先：〒

TEL：FAX：E-mail：

会員資格：当専門委員会会員 非会員（不要な方を削除して下さい）

研究会：出席 欠席（不要な方を削除して下さい）

技術交流会：出席 欠席（不要な方を削除して下さい）